

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (电话会议)
参与单位及人员	易方达基金 永赢基金 华夏基金 富国基金 汇添富基金 建信基金 招商基金 招银理财 交银施罗德基金 农银汇理基金 上银基金 太平养老 长江养老 友邦人寿 光大保德信基金 金鹰基金 诺德基金 兴业基金 太平基金 华商基金 长信基金 银华基金 华安基金 东吴基金 安联基金 海富通基金 富安达基金 惠升基金 同泰基金 长安基金 申万菱信 南土资产 国华兴益 路博迈 中银国际 青骊投资 弘毅远方 君屹投资 豪胜资产 全天候基金磐厚投资 国泰海通证券 华安证券 兴业证券 广发证券 华福证券 国信证券 浙商证券 国联民生证券 朴拙资本 东方证券自营 山西证券 盛宇投资 华泰证券 国盛证券资管 方正和生 通乾投资 宏颐资本 中金资管 冲击资产
时间	2025年12月17日
地点	机构会议室 及 线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司拟成立的产业投资基金情况及其进展</p> <p>公司2025年12月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》，拟与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司开展战略合作，共同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，总规模不低于2亿元。其中公司认缴出资比例为30%。</p> <p>成立该基金，是公司落实外延式发展的诸多路径之一。</p> <p>该基金将结合公司的产业优势，重点关注围绕晶圆制造需要的关键设备、零部件、材料等方向进行布局；基金的投资地域重点聚焦于中国境内，兼顾布局全</p>

球及投资拥有先进技术、优质产能且有望引进国内的海外优秀标的公司。

2025年12月17日，公司披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》，公司与管理人国泰君安创新投资及其他合伙人正式签署了合伙协议。截止目前，该基金已完成合伙协议的签署、收到缴款通知并取得了武汉市江汉区行政审批局颁发的《营业执照》。

二、公司是否有日资背景

公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。

三、公司业绩与存储芯片产业的关系

公司的硅零部件产品，由大直径硅材料加工而成，其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，是需要定期更换的核心耗材；其更换频率与存储芯片制造产线的开工率和刻蚀应用强度相关——开工率越高，刻蚀次数越多、强度越大，对硅零部件的消耗就越多。

随着存储芯片先进制程向着3D堆叠方向不断进展，需要更多高深宽比刻蚀；且存储芯片电路线宽向着10nm以下进展，需要更大直径的硅零部件。因此，定性来看，伴随技术革新，先进制程存储芯片制造厂的刻蚀用量将增长，硅零部件的需求量将增大。

四、公司硅零部件产品的验证导入情况

公司硅零部件业务起步于2016年，是中国最早开拓该市场的本土企业。

公司所具备的“自产材料+零部件”的一体化研发生产能力，在中国本土厂商中独树一帜，产销量居于本土厂商前列，具备独特的技术优势和成本优势，拥有可持续的长期竞争力。

在过去数年中，公司硅零部件产品已经进入北方华创、中微公司等中国本土主流等离子刻蚀设备厂商，以及长江存储、长鑫存储、福建晋华、SK海力士（大连）等主流存储芯片制造厂，业绩连年增长，在中国芯片制造国产化中发挥了独

特作用。

公司具备服务于中国全品类客户的技术研发和生产能力且持续扩产，但考虑到下游需求规模，产能仍相对不足，目前销售结构阶段性地以等离子刻蚀设备厂商为主。

五、公司硅零部件产品的本土需求来源

第一，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局，不断增长的产量和技术革新，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套；

第二，中国芯片制造国产化进程进入“深水区”，供应链安全需求迫切，国产设备厂商技术水平不断提升并追赶上世界先进水平，产品持续迭代升级，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套；

第三，某些国家对跨国公司设立于中国大陆的存储芯片制造厂加以反复无常的技术钳制和产能限制，迫使后者将目光投向中国本土供应链，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套。

综上，需求来源多样，市场机会窗口敞开，综合市场研究机构的公开数据和市场部的调研，公司认为当前中国本土市场的硅零部件需求约为60亿元人民币/年，未来五年的年化增长率不低于15%。

六、公司大直径硅材料的产能和定价情况

公司大直径硅材料产能曾经在上一轮周期景气高点达到满产状态。为此，公司于2023年进行了小额快速定增募资，用于大直径硅材料的新增产能建设。公司该产品的市场销售价格保持稳定。

当前，公司大直径硅材料产能居于全球前列，足以应对潜在增量需求，开工率提升空间较大，且具备在半导体周期景气时继续扩产的资金和技术能力。

七、存储市场变化与未来趋势研判

展望2025年第四季度以及2026年，公司认为当前半导体产业正在“换档变速”：今年以来，全球科技巨头对算力中心的单季度资本开支金额，已经从此前

的300亿至400亿美元，大幅增加到800亿至1,000亿美元的历史新高，并叠加年底消费电子产业链备料出货需求，因此存储芯片产能出现结构性短缺；中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局；此外，消费者端侧应用创新正在加速，有望为半导体周期上行带来最根本且持久的市场驱动力。

公司大直径硅材料的制成品硅零部件，主要应用于存储芯片制造厂的刻蚀环节，开工率越高，使用量越大。公司认为，半导体产业周期上行有望带来更多市场需求。公司是上游材料及零部件供应商，如果下游终端存储芯片制造厂的开工率提升乃至资本开支增加带来新的需求，一般需要约1-2个季度传导到公司。本月初开始，公司已经与日本、韩国客户接洽新订单。

八、硅零部件业务的扩产进度

土地、厂房、设备等生产要素的整备只是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续健康发展。

因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力保持良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。

前三季度，公司的硅零部件产能扩张方针“稳”字当头，产品结构改善，成本有所下降，毛利率稳中有升，取得良好成效。公司已从第三季度开始按计划增加产能，将继续参考过去几年的业绩增速曲线，合理配置资源，争取扩产质量和扩产速度之最佳平衡。

九、公司未来计划

公司将稳健扩产并提升硅零部件产品收入；公司还计划抓住中国本土硅片市场供求关系的局部变化，满足下游客户的国产化需求；公司大直径硅材料产能全球领先，开工率提升空间较大，已经为新的外部需求做好准备，并为硅零部件业务的长远发展奠定坚实基础。

	<p>公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，提高了公司向金融机构申请授信的额度，从3.5亿元提高至8亿元。</p> <p>综上，公司管理层已为接下来的潜在市场变化做好充分的产能和资金准备，将通过更高的资金使用效率来加强股东回报。</p> <p>纵观国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。公司将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。</p>
附件清单	无
日期	2025年12月18日